

FID2

FID3

FID1

El diseno se realiza con los siguientes parametros:

- * Ancho de pista de 0.8 mm.*
- * Pads de COBRE con recubrimiento de FLUX.*
- * Mascara antisoldante verde.*
- * Terminacion superficial de pads HASL.*
- * Grilla de 1mm para Posicionamiento y 0,5mm para Routeo.*
- * Pad minimo 0,7 mm*
- * Espesor de placa (standard) 1.6 mm.*
- * Espesor de cobre (standard) 35 um.*
- * Material de Sustrato: FR4.*
- * DOBLE FAZ con componentes unicamente en la capa frontal.*
- * Se desea mantener un margen de 2 mm en toda la periferia de la placa, exceptuando el lado superior (para conexion de modulo RF)*
- * Margen entre componentes de 0,6 mm.*
- * Fabricacion Manual, en su defecto (Mayer Argenitna).*